



電子情報技術産業協会技術レポート

Technical Report of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

JEITA EDR-7335

半導体パッケージ用語集
(第一部 パッケージ名称及び部位名称)
Glossary for Semiconductor packages
(Volume 1: Semiconductor package name and parts name)

2010 年 11 月制定

作 成

半導体技術委員会／半導体実装・製品技術専門委員会

Semiconductor Technology Committee/Semiconductor Product Technology Committee of Japan

半導体パッケージ技術小委員会

Technical Committee on Semiconductor Packaging

発 行

社団法人 電子情報技術産業協会

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

まえがき

この技術レポートは、社団法人 電子情報技術産業協会（**JEITA**）の半導体パッケージ技術小委員会 共通規格サブコミティが作成し、同小委員会の審議・承認を経て発行された。

この技術レポートは、著作権法によって保護されている著作物であるため、許可なくこの規格の一部又はすべてを複製・転載することを禁止する。

また、この技術レポートは、その一部が、工業所有権（特許権、実用新案権、意匠権など）に抵触する可能性に関係なく制定されている。社団法人 電子情報技術産業協会は、このような工業所有権にかかわる責任は負わない。

この技術レポートは、**JEITA TSC-16**（電子情報技術産業協会規格類の作成基準）の様式に則って作成された。

電子情報技術産業協会技術レポート

半導体パッケージ用語集
(第一部 パッケージ名称及び部位名称)Glossary for Semiconductor packages
(Volume 1: Semiconductor package name and parts name)

1 適用範囲

この技術レポートは、**JEITA ED-7300A** で規定されている集積回路に用いられる半導体パッケージ（以下、「パッケージ」という。）の名称及びその部位名称について規定する。

2 引用規格及び文書

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、西暦年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版又は追補には適用しない。

JEITA ED-7300A	半導体パッケージの外形規格作成に関する基本事項
JEITA ED-7303C	集積回路パッケージの名称及びコード
JEITA ETR-7001	表面実装用語
JEITA TSC-16	電子情報技術産業協会規格類の作成基準

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、引用規格及び文書に掲げる規格によるほか、次による。

3.1

パッケージ名称

JEITA ED-7303C で規定される、パッケージ名称。

3.2

定義されないパッケージ名称

JEITA ED-7303C で規定されていないが、業界で広く認知されている、又は過去に認知されていたパッケージの名称。

3.3

パッケージ部位名称

主として **JEITA ED-7300A** で規定される、パッケージの各部位を定義する呼称。

3.4

パッケージ図面用語

パッケージ図面を記述する際に用いられる用語。

3.5

関連用語

定義ではないながらも、業界で広く知れ渡っている用語。